

# 2023-2029年中国晶圆行业市场运行态势及未来趋势预测报告

报告大纲

智研咨询

[www.chyxx.com](http://www.chyxx.com)

## 一、报告简介

智研咨询发布的《2023-2029年中国晶圆行业市场运行态势及未来趋势预测报告》涵盖行业最新数据，市场热点，政策规划，竞争情报，市场前景预测，投资策略等内容。更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展态势、市场商机动向、正确制定企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据，以及我中心对本行业的实地调研，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。

官网地址：<https://www.chyxx.com/research/1138170.html>

报告价格：电子版: 9800元 纸介版：9800元 电子和纸介版: 10000元

订购电话: 010-60343812、010-60343813、400-600-8596、400-700-9383

电子邮箱: sales@chyxx.com

联系人: 刘老师

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

## 二、报告目录及图表目录

智研咨询发布的《2023-2029年中国晶圆行业市场运行态势及未来趋势预测报告》共十三章。首先介绍了晶圆行业市场发展环境、晶圆整体运行态势等，接着分析了晶圆行业市场运行的现状，然后介绍了晶圆市场竞争格局。随后，报告对晶圆做了重点企业经营状况分析，最后分析了晶圆行业发展趋势与投资预测。您若想对晶圆产业有个系统的了解或者想投资晶圆行业，本报告是您不可或缺的重要工具。

本研究报告数据主要采用国家统计局数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据，企业数据主要来自于国统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格数据主要来自于各类市场监测数据库。

报告目录：

### 第一章 晶圆概述

#### 1.1 晶圆相关概念

##### 1.1.1 晶圆定义

##### 1.1.2 晶圆制造

##### 1.1.3 晶圆产业链

#### 1.2 晶圆制造相关工艺

##### 1.2.1 晶圆制造流程

##### 1.2.2 热处理工艺

##### 1.2.3 光刻工艺

##### 1.2.4 刻蚀工艺

##### 1.2.5 薄膜沉积工艺

##### 1.2.6 化学机械研磨工艺

##### 1.2.7 清洗工艺

### 第二章 2018-2022年国内外半导体行业发展情况

#### 2.1 半导体产业概述

##### 2.1.1 半导体产业概况

##### 2.1.2 半导体产业链构成

##### 2.1.3 半导体产业运作模式

##### 2.1.4 集成电路制造行业

#### 2.2 2018-2022年全球半导体市场分析

- 2.2.1 市场销售规模
- 2.2.2 产业研发投入
- 2.2.3 行业产品结构
- 2.2.4 区域市场格局
- 2.2.5 企业营收排名
- 2.2.6 市场规模预测
- 2.3 2018-2022年中国半导体市场运行状况
  - 2.3.1 产业销售规模
  - 2.3.2 产业区域分布
  - 2.3.3 国产替代加快
  - 2.3.4 市场需求分析
  - 2.3.5 行业发展前景
- 2.4 中国半导体产业发展问题分析
  - 2.4.1 产业发展短板
  - 2.4.2 技术发展壁垒
  - 2.4.3 贸易摩擦影响
  - 2.4.4 市场垄断困境
- 2.5 中国半导体产业发展措施建议
  - 2.5.1 产业发展战略
  - 2.5.2 产业发展路径
  - 2.5.3 研发核心技术
  - 2.5.4 人才发展策略
  - 2.5.5 突破垄断策略

### 第三章 2018-2022年国际晶圆产业发展综述

- 3.1 全球晶圆制造行业发展情况
  - 3.1.1 晶圆制造投资分布
  - 3.1.2 晶圆制造设备市场
  - 3.1.3 企业晶圆产能排名
  - 3.1.4 晶圆细分市场份额
- 3.2 全球晶圆代工市场发展
  - 3.2.1 全球晶圆代工市场规模
  - 3.2.2 全球晶圆代工地区分布
  - 3.2.3 全球晶圆代工市场需求
- 3.3 全球晶圆代工产业格局

- 3.3.1 全球晶圆代工企业排名
- 3.3.2 晶圆代工TOP10企业
- 3.3.3 晶圆二线专属代工企业
- 3.3.4 IDM兼晶圆代工企业
- 3.4 中国台湾地区晶圆产业发展情况
  - 3.4.1 中国台湾晶圆产业发展地位
  - 3.4.2 中国台湾晶圆产业发展规模
  - 3.4.3 中国台湾晶圆代工产能分析
  - 3.4.4 中国台湾晶圆代工竞争格局
  - 3.4.5 中国台湾晶圆代工需求趋势

#### 第四章 2018-2022年中国晶圆产业发展环境分析

- 4.1 政策环境
  - 4.1.1 产业扶持政策
  - 4.1.2 税收利好政策
  - 4.1.3 支持进口政策
- 4.2 经济环境
  - 4.2.1 宏观经济概况
  - 4.2.2 工业经济运行
  - 4.2.3 对外经济分析
  - 4.2.4 固定资产投资
  - 4.2.5 宏观经济展望
- 4.3 社会环境
  - 4.3.1 研发投入情况
  - 4.3.2 从业人员情况
  - 4.3.3 行业薪酬水平

#### 第五章 2018-2022年中国晶圆产业发展综述

- 5.1 中国IC制造行业发展
  - 5.1.1 行业发展特点
  - 5.1.2 行业发展规模
  - 5.1.3 市场竞争格局
  - 5.1.4 设备供应情况
  - 5.1.5 行业发展趋势
- 5.2 中国晶圆产业发展分析

- 5.2.1 晶圆产业转移情况
- 5.2.2 晶圆制造市场规模
- 5.2.3 晶圆厂布局走向
- 5.3 中国晶圆厂生产线发展
  - 5.3.1 12英寸生产线
  - 5.3.2 8英寸生产线
  - 5.3.3 6英寸生产线
- 5.4 中国晶圆代工市场发展情况
  - 5.4.1 晶圆代工市场规模
  - 5.4.2 晶圆代工公司
  - 5.4.3 晶圆代工市场机会
- 5.5 中国晶圆产业发展面临挑战及对策
  - 5.5.1 行业发展不足
  - 5.5.2 行业面临挑战
  - 5.5.3 行业发展对策

## 第六章 2018-2022年晶圆制程工艺发展分析

- 6.1 晶圆制程主要应用技术
  - 6.1.1 晶圆制程逻辑工艺技术
  - 6.1.2 晶圆制程特色工艺技术
  - 6.1.3 不同晶圆制程应用领域
  - 6.1.4 晶圆制程逻辑工艺分类
  - 6.1.5 晶圆制程工艺发展前景
- 6.2 晶圆先进制程发展分析
  - 6.2.1 主要先进制程工艺
  - 6.2.2 先进制程发展现状
  - 6.2.3 先进制程产品格局
  - 6.2.4 先进制程晶圆厂分布
- 6.3 晶圆成熟制程发展分析
  - 6.3.1 成熟制程发展优势
  - 6.3.2 成熟制程应用现状
  - 6.3.3 成熟制程企业排名
  - 6.3.4 成熟制程代表企业
  - 6.3.5 成熟制程需求趋势
- 6.4 晶圆制造特色工艺发展分析

#### 6.4.1 特色工艺概述

#### 6.4.2 特色工艺特征

#### 6.4.3 市场发展现状

#### 6.4.4 市场需求前景

### 第七章 2018-2022年晶圆产业链上游——硅片产业发展情况

#### 7.1 半导体硅片概述

##### 7.1.1 半导体硅片简介

##### 7.1.2 硅片的主要种类

##### 7.1.3 半导体硅片产品

##### 7.1.4 半导体硅片制造工艺

##### 7.1.5 半导体硅片技术路径

##### 7.1.6 半导体硅片制造成本

#### 7.2 全球半导体硅片发展分析

##### 7.2.1 全球硅片产业情况

##### 7.2.2 全球硅片价格走势

##### 7.2.3 主要硅片产商布局

##### 7.2.4 全球硅片企业收购

#### 7.3 国内半导体硅片行业发展分析

##### 7.3.1 国内硅片发展现状

##### 7.3.2 国内硅片需求分析

##### 7.3.3 国内主要硅片企业

##### 7.3.4 硅片主要下游应用

##### 7.3.5 国产企业面临挑战

#### 7.4 硅片制造主要壁垒

##### 7.4.1 技术壁垒

##### 7.4.2 认证壁垒

##### 7.4.3 设备壁垒

##### 7.4.4 资金壁垒

#### 7.5 半导体硅片行业发展展望

##### 7.5.1 技术发展趋势

##### 7.5.2 市场发展前景

##### 7.5.3 国产硅片机遇

### 第八章 2018-2022年晶圆产业链中游——晶圆制造设备发展

## 8.1 光刻设备

### 8.1.1 光刻机种类

### 8.1.2 光刻机主要构成

### 8.1.3 光刻机技术迭代

### 8.1.4 光刻机发展现状

### 8.1.5 光刻机竞争格局

### 8.1.6 光刻机产品革新

### 8.1.7 国产光刻机发展

## 8.2 刻蚀设备

### 8.2.1 刻蚀工艺简介

### 8.2.2 刻蚀机主要分类

### 8.2.3 刻蚀设备发展规模

### 8.2.4 刻蚀加工需求增长

### 8.2.5 全球刻蚀设备格局

### 8.2.6 国内主要刻蚀企业

## 8.3 薄膜沉积设备

### 8.3.1 薄膜工艺市场规模

### 8.3.2 薄膜工艺市场份额

### 8.3.3 薄膜设备国产化进程

## 8.4 清洗设备

### 8.4.1 清洗设备技术分类

### 8.4.2 清洗设备市场规模

### 8.4.3 清洗设备竞争格局

### 8.4.4 清洗设备发展趋势

## 第九章 2018-2022年晶圆产业链中游——晶圆先进封装综述

### 9.1 先进封装基本介绍

#### 9.1.1 先进封装基本含义

#### 9.1.2 先进封装发展阶段

#### 9.1.3 先进封装系列平台

#### 9.1.4 先进封装影响意义

#### 9.1.5 先进封装发展优势

#### 9.1.6 先进封装技术类型

#### 9.1.7 先进封装技术特点

### 9.2 先进封装关键技术分析



- 9.2.1 堆叠封装
- 9.2.2 晶圆级封装
- 9.2.3 2.5D/3D技术
- 9.2.4 系统级封装SiP技术
- 9.3 中国先进封装技术市场发展现状
  - 9.3.1 先进封装市场发展规模
  - 9.3.2 先进封装产能布局分析
  - 9.3.3 先进封装技术份额提升
  - 9.3.4 企业先进封装技术竞争
  - 9.3.5 先进封装企业营收状况
  - 9.3.6 先进封装技术应用领域
  - 9.3.7 先进封装技术发展困境
- 9.4 中国芯片封测行业运行状况
  - 9.4.1 市场规模分析
  - 9.4.2 主要产品分析
  - 9.4.3 企业类型分析
  - 9.4.4 企业市场份额
  - 9.4.5 区域分布占比
- 9.5 先进封装技术未来发展空间预测
  - 9.5.1 先进封装技术趋势
  - 9.5.2 先进封装前景展望
  - 9.5.3 先进封装发展趋势
  - 9.5.4 先进封装发展战略

## 第十章 2018-2022年晶圆产业链下游应用分析

- 10.1 车用芯片
  - 10.1.1 车载芯片基本介绍
  - 10.1.2 车载芯片需求特点
  - 10.1.3 车用晶圆需求情况
  - 10.1.4 车企布局晶圆厂动态
  - 10.1.5 车载芯片供应现状
  - 10.1.6 车用芯片市场潜力
  - 10.1.7 车载芯片发展走势
- 10.2 智能手机芯片
  - 10.2.1 智能手机芯片介绍

#### 10.2.2 智能手机芯片规模

#### 10.2.3 智能手机出货情况

#### 10.2.4 手机芯片制程工艺

#### 10.2.5 手机芯片需求趋势

### 10.3 服务器芯片

#### 10.3.1 服务器芯片发展规模

#### 10.3.2 服务器芯片需求现状

#### 10.3.3 服务器芯片市场格局

#### 10.3.4 国产服务器芯片发展

#### 10.3.5 服务器芯片需求前景

### 10.4 物联网芯片

#### 10.4.1 物联网市场规模

#### 10.4.2 物联网芯片应用

#### 10.4.3 国产物联网芯片发展

#### 10.4.4 物联网芯片竞争格局

#### 10.4.5 物联网芯片发展预测

## 第十一章 国内外晶圆产业重点企业经营分析

### 11.1 台湾积体电路制造公司

#### 11.1.1 企业发展概况

#### 11.1.2 企业产能情况

#### 11.1.3 先进制程布局

#### 11.1.4 企业经营状况分析

### 11.2 联华电子股份有限公司

#### 11.2.1 企业发展概况

#### 11.2.2 企业产能情况

#### 11.2.3 先进制程布局

#### 11.2.4 企业经营状况分析

### 11.3 中芯国际集成电路制造有限公司

#### 11.3.1 企业发展概况

#### 11.3.2 主要业务分析

#### 11.3.3 企业经营模式

#### 11.3.4 经营效益分析

### 11.4 华虹半导体有限公司

#### 11.4.1 企业发展概况

- 11.4.2 企业业务分析
- 11.4.3 企业经营状况分析
- 11.4.4 企业产能情况
- 11.5 华润微电子有限公司
  - 11.5.1 企业发展概况
  - 11.5.2 晶圆制造业务
  - 11.5.3 经营模式分析
  - 11.5.4 经营效益分析
- 11.6 其他企业
  - 11.6.1 上海先进半导体制造有限公司
  - 11.6.2 和舰芯片制造（苏州）股份有限公司
  - 11.6.3 联芯集成电路制造(厦门)有限公司

## 第十二章 晶圆产业投融资分析

- 12.1 集成电路产业投资基金发展
  - 12.1.1 大基金发展相关概况
  - 12.1.2 大基金投资企业模式
  - 12.1.3 大基金一期发展回顾
  - 12.1.4 大基金二期发展现状
  - 12.1.5 大基金二期布局方向
- 12.2 晶圆产业发展机遇分析
  - 12.2.1 晶圆行业政策机遇
  - 12.2.2 晶圆下游应用机遇
  - 12.2.3 晶圆再生发展机会
- 12.3 晶圆制造项目投资动态
  - 12.3.1 名芯半导体晶圆生产线项目
  - 12.3.2 闻泰科技车用晶圆制造项目
  - 12.3.3 百识半导体6寸晶圆制造项目
  - 12.3.4 杰利大功率半导体晶圆项目
- 12.4 晶圆产业投融资风险
  - 12.4.1 研发风险
  - 12.4.2 竞争风险
  - 12.4.3 资金风险
  - 12.4.4 原材料风险

## 第十三章 2023-2029年中国晶圆产业发展前景及趋势预测分析

### 13.1 晶圆产业发展趋势展望

#### 13.1.1 全球晶圆厂发展展望

#### 13.1.2 全球晶圆代工发展趋势

#### 13.1.3 全球晶圆细分产品趋势

#### 13.1.4 中国晶圆代工发展趋势

### 13.2 2023-2029年中国晶圆产业预测分析

#### 13.2.1 2023-2029年中国晶圆产业影响因素分析

#### 13.2.2 2023-2029年中国晶圆产业规模预测

### 图表目录

图表 每5万片晶圆产能的设备投资

图表 晶圆行业产业链

图表 氧化工艺的用途

图表 光刻工艺流程图

图表 光刻工艺流程

图表 等离子刻蚀原理

图表 湿法刻蚀和干法刻蚀对比

图表 离子注入与扩散工艺比较

图表 离子注入机示意图

图表 离子注入机细分市场格局

图表 IC集成电路离子注入机市场格局

图表 三种CVD工艺对比

更多图表见正文.....

详细请访问：<https://www.chyxx.com/research/1138170.html>